

**上海硅产业集团股份有限公司董事会**  
**关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金**  
**前 12 个月内购买、出售资产情况的说明**

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司（以下简称“新昇晶投”）、上海新昇晶科半导体科技有限公司（以下简称“新昇晶科”）、上海新昇晶睿半导体科技有限公司（以下简称“新昇晶睿”，和新昇晶投、新昇晶科合称“标的公司”）的少数股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”）。

同时，上市公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次交易”）。

本次交易完成后，公司将通过直接和间接方式持有新昇晶投 100%股权、新昇晶科 100%股权、新昇晶睿 100%股权。

《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第十四条第一款第（四）项的相关规定，“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

本次交易前 12 个月内，公司通过全资子公司与其他方共同出资，投资设立控股子公司太原晋科硅材料技术有限公司。根据《重组管理办法》的规定，前述投资涉及标的资产与标的公司新昇晶投、新昇晶科、新昇晶睿均从事半导体硅片制造，属于相同或者相近业务范围，需纳入本次交易的累计计算范围。

除上述事项外，公司在本次交易前 12 个月内未发生《重组管理办法》规定的与本次交易相关的重大购买、出售资产交易行为。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海硅产业集团股份有限公司董事会关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前 12 个月内购买、出售资产情况的说明》之签章页）

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日